

## 附件：IC 新創落地輔導資源需求表

辦法說明：

藉助臺灣在半導體領先的實力與豐沛的資源，彙整晶片開發所需之關鍵資源，協助全球 IC 新創在台落地實現潛力產品。

詳細需求說明：(請詳細說明產品與需求細節，包括產品規格、製程節點、台灣廠商合作內容等)

☐ 產品名稱與功能方塊圖(Block diagram)：

☐ 產品規格：(請條列細節)

產品開發之資源需求：(可複選並說明)

☐ EDA tool 需求：\_\_\_\_\_

☐ IP 需求：\_\_\_\_\_

☐ IC 設計服務需求：\_\_\_\_\_

☐ 規劃投片晶圓廠：\_\_\_\_\_

☐ 製程節點：\_\_\_\_\_ nm

☐ 製程類型 type (GP, BCD, RF, Mixed-Signal...etc.)：\_\_\_\_\_

☐ 封測需求：\_\_\_\_\_

☐ 系統整合需求：\_\_\_\_\_

☐ 設備製造商：

☐ 產品開發之時程規劃：

☐ 已接洽過之臺灣廠商：

其他需求說明：(可複選並說明)

- ☐ 商務發展需求：\_\_\_\_\_
- ☐ 募資需求：\_\_\_\_\_
- ☐ 在台設立公司：\_\_\_\_\_
- ☐ 其他（可條列說明，如產品開發需求之額外補充....等）：\_\_\_\_\_

### 股權資料內容

#### 股權結構：

股東名稱	國籍	持股比例

簽名同意(公司以負責人或 CEO 簽署；未成立公司之團隊則需所有團隊成員簽署)：\_\_\_\_\_